

お問合せ先
OBARA GROUP株式会社
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3-2-10
TEL. 046-271-2122

適切に管理された森林からの原料を含むFSC®認証紙之環境に配慮した植物油インキを使用
しています。



www.obara-g.com

OBARA-G REPORT

第63期 第2四半期報告書

2020年10月1日………2021年3月31日

証券コード 6877

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2021年第2四半期連結累計期間における事業の概況等をご報告致します。

世界経済は、新型コロナウイルス感染症の流行により多方面の経済活動が抑制されましたが、総体的には緩やかな回復基調となりました。

我が国経済につきましては、同感染症による個人消費への影響が続きましたが、設備投資や生産活動が底堅く推移するなど、景気に持ち直しの動きが見られました。

そのような外部環境の下、溶接機器関連事業が、自動車メーカーの前向きな設備投資動向への対応に努め、平面研磨装置関連事業が、堅調な生産活動が続くエレクトロニクス関連素材への拡販活動を図りましたが、当社の業績は、前年同期を下回る結果となりました。

なお、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策として認識しており、2020年4月から2021年4月までに1,780,400株(自己株式を除く発行済株式総数の10.96%)の自己株式を取得するとともに、2021年度の第2四半期末配当金につきましては、1株につき40円とし、本年6月7日を支払開始日とさせていただきます。



今後も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍旧のご支援を心よりお願い申し上げます。

2021年6月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶01	セグメント別事業概況 ▶05	主要経営指標の推移 ▶11	会社情報 ▶16	株主メモ ▶18
	営業の概況 ▶03	トピックス ▶09	連結財務データ ▶13	株式情報 ▶17	



連結業績サマリー

(百万円)

	第2四半期累計期間			通期		
	前期	当期	前年同期比	前期	当期(予想)	前期比
売上高	21,307	20,866	△2.1%	44,230	41,500	△6.2%
営業利益	3,367	3,506	4.1%	6,754	6,600	△2.3%
経常利益	3,845	3,980	3.5%	7,474	7,100	△5.0%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	2,549	2,529	△0.8%	5,103	5,400	5.8%
1株当たり配当金	40円	40円	—	110円(年間)	110円(年間)	—

(注) 前期の期末配当金(確定)／1株当たり配当金70円
 当期の期末配当金(予想)／1株当たり配当金70円

第2四半期連結累計期間の概況について

当社グループと深く関わる自動車業界につきましては、生産活動は総じて改善傾向が継続し、設備投資についても前向き姿勢が強まりました。一方、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、半導体デバイス向け設備投資に活性化の動きが見られる中、エレクトロニクス関連素材では堅調な設備投資が行われました。

当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努め、ローカルニーズに対応した製品投入を進めたものの、第2四半期連結累計期間の業績は前年同期を下回る結果となりました。

通期の見通しについて

最新の経営環境を踏まえ、2021年4月30日に期初計画を上回る連結業績予想に修正しました。

通期の業績は、売上高415億円(前期比6.2%減)、営業利益66億円(前期比2.3%減)、経常利益71億円(前期比5.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益54億円(前期比5.8%増)を予定しております。

当社グループとしましては、業績の向上に鋭意注力すべく、成長市場での販売促進を鋭意図るとともに、継続的に設備投資と研究開発を行ってまいります。

なお、当連結業績予想は、1米ドル=105.00円の為替レートを前提としております。

セグメント別事業概況

溶接機器
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

● 溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



車体溶接の設備

OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

溶接機器関連事業



溶接ガン

売上高構成比

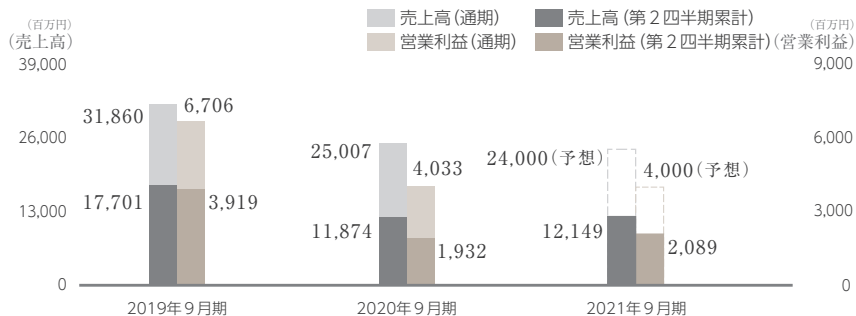
12,149

百万円……2021年9月期
第2四半期累計売上高

平面研削装置関連事業

溶接機器
関連事業

58.2%



溶接機器関連事業につきましては、取引先である自動車業界において、設備投資及び生産活動の回復傾向がアジア地域に見られました。このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったことなどにより、業績は堅調に推移しました。

この結果、当事業の売上高は121億49百万円(前年同期比2.3%増)、同営業利益は20億89百万円(前年同期比8.1%増)となりました。

セグメント別事業概況

平面研磨装置
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

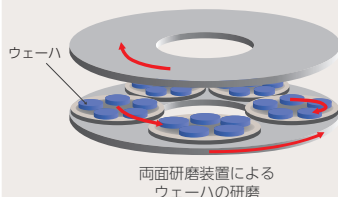
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程
インゴット引き上げ、切断、
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程
成膜、リソグラフィ、
エッチング等

半導体デバイス後工程
ダイシング、ボンディング、
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込
完成した半導体デバイス(チップ)の
エレクトロニクス製品への搭載

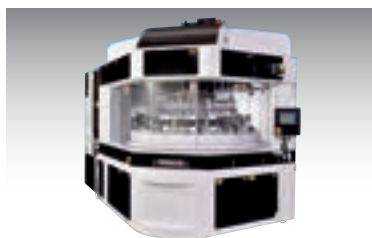


OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

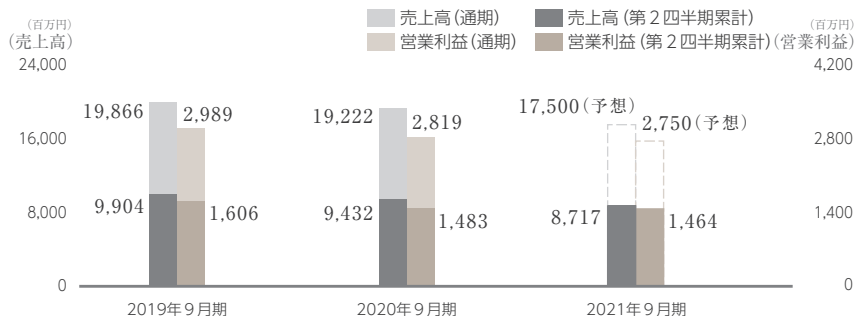
精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

平面研磨装置関連事業



両面研磨装置



売上高構成比

8,717

百万円 2021年9月期
第2四半期累計売上高

溶接機器
関連事業

平面研磨装置関連事業

41.8%

平面研磨装置関連事業につきましては、半導体メモリー等の需要量が高水準で推移し、取引先であるエレクトロニクス関連素材においても堅調な生産活動や設備投資が続きました。このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったものの、業績は前年同期を下回りました。

この結果、当事業の売上高は87億17百万円(前年同期比7.6%減)、同営業利益は14億64百万円(前年同期比1.3%減)となりました。

トピックス

平面研磨装置関連事業／ SEMICON Japanに出展

スマートフォンなどのエレクトロニクス製品には最先端の半導体デバイスが搭載され、そのデバイスが形成されるシリコンウェーハの高精度化が進んでいます。2020年12月、新型コロナウイルス感染症の影響などからオンライン開催となった半導体製造技術の展示会「SEMICON Japan Virtual」にて、当社グループは、次世代シリコンウェーハに適應した装置・消耗副資材の総合ソリューションを提案したほか、SiCやGaNなどの新素材や、極薄水晶基板に対応した最新の研磨装置シリーズを紹介しました。

当社グループは、顧客ニーズを具現化する次世代装置など、高付加価値製品の開発に注力してまいります。



SEMICON Japan 2020 Virtual

平面研磨装置関連事業／ SEMICON Chinaに出展

電気・電子産業の成長が続く中国では、関連材料の製造に関わる装置需要の拡大が期待されます。当社グループは、2021年3月、上海(中国)で開催された半導体関連技術の総合展示会「SEMICON China」において精密研磨装置などを紹介し、化合物基板や酸化物基板、精密金属部品などのアプリケーションに対する最新の取組み内容を展示しました。また、ご来場の方々に対し、豊富な装置ラインナップと各種消耗副資材による効果的な製造プロセスについても紹介し、注目を浴びました。

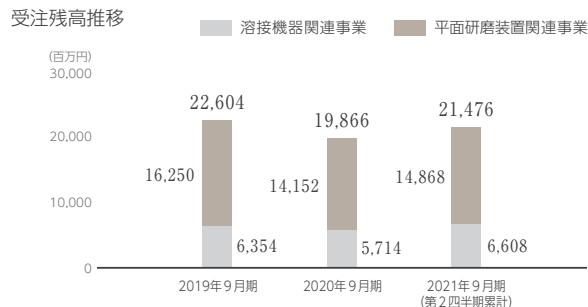
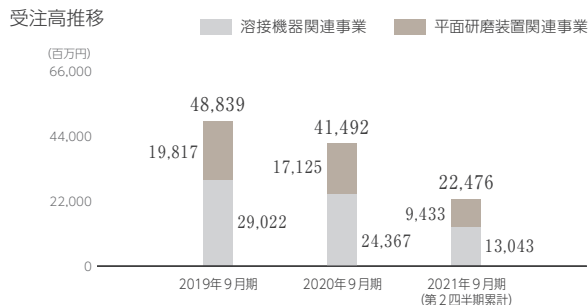
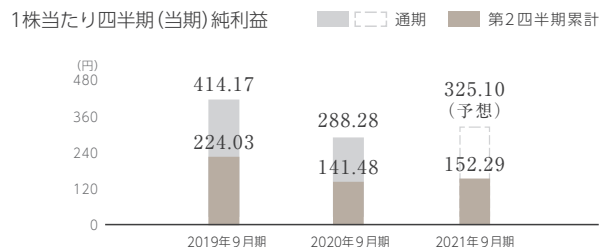
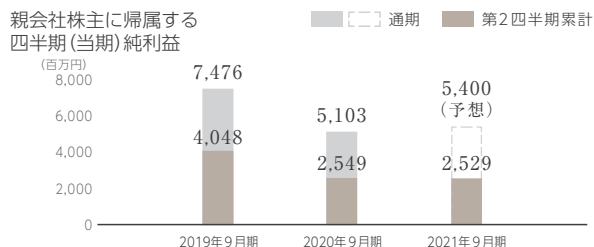
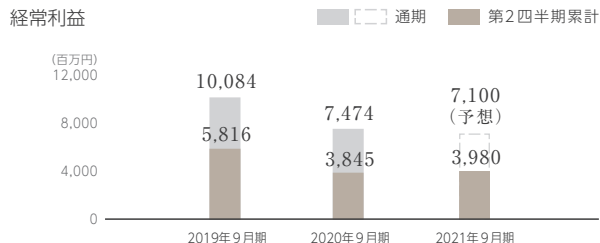
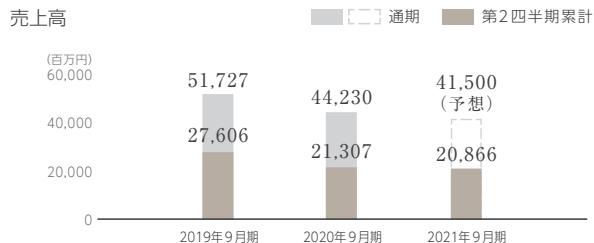
当社グループは、独創的な製品群のご提供を通じ、常にお客様のご要望にお応えしてまいります。



SEMICON China 2021

主要経営指標の推移

詳細情報は当社IRサイトをご覧ください。 <http://www.obara-g.com/jp/ir/library/index.html>



地域別売上高構成比



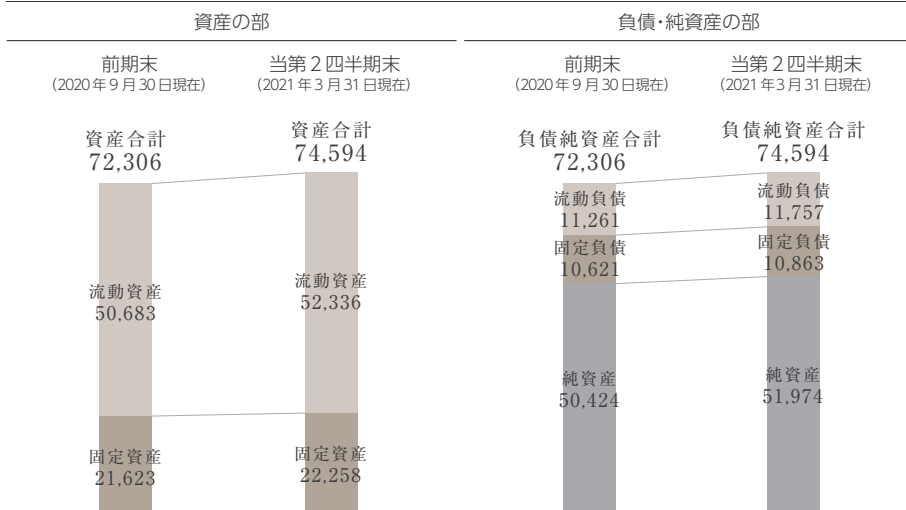
- 日本 39.9%
- 米州 7.7%
- アジア・パシフィック 48.7%
- その他 3.7%

(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。



資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



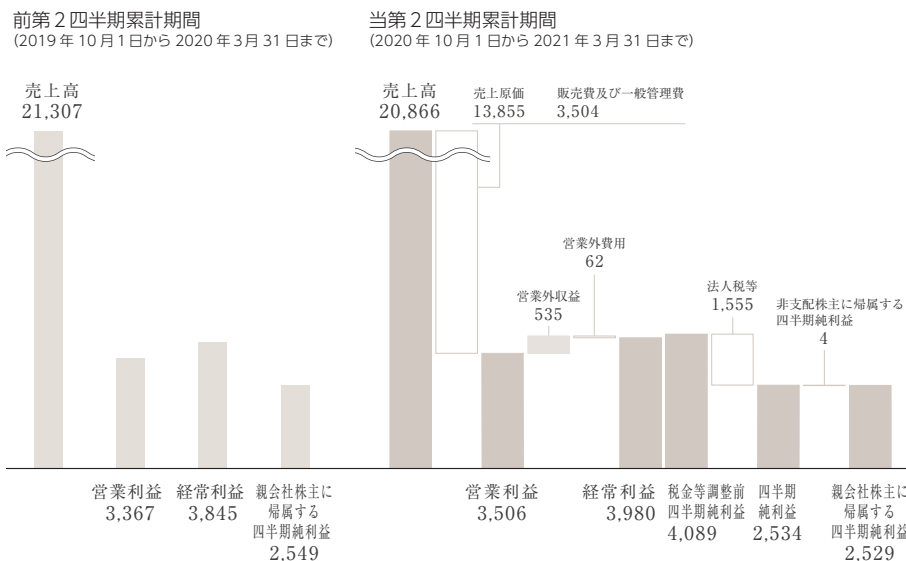
point
1

資産負債

総資産は745億94百万円と、前期末に比べて22億88百万円増加しました。受取手形及び売掛金が6億84百万円、電子記録債権が8億74百万円減少した一方、現金及び預金が24億51百万円、たな卸資産が3億63百万円、流動資産のその他が3億2百万円、有形固定資産のその他（純額）が6億13百万円増加したことなどによります。負債は226億20百万円と、前期末に比べて7億37百万円増加しました。短期借入金が1億84百万円、賞与引当金が2億50百万円、流動負債のその他が1億10百万円減少した一方、前受金が9億94百万円、繰延税金負債が2億98百万円増加したことなどによります。

損益の状況

(単位：百万円)



point
2

純資産

純資産は519億74百万円と、前期末に比べて15億50百万円増加しました。自己株式の取得により24億94百万円減少した一方、利益剰余金が13億42百万円、為替が前期末より円安のため為替換算調整勘定が26億95百万円増加したことなどによります。

point
3

売上高・営業利益・
経常利益・親会社株主に
属する四半期純利益

連結売上高208億66百万円(前年同期比2.1%減)、営業利益35億6百万円(前年同期比4.1%増)、経常利益39億80百万円(前年同期比3.5%増)、親会社株主に属する四半期純利益は、25億29百万円(前年同期比0.8%減)となりました。

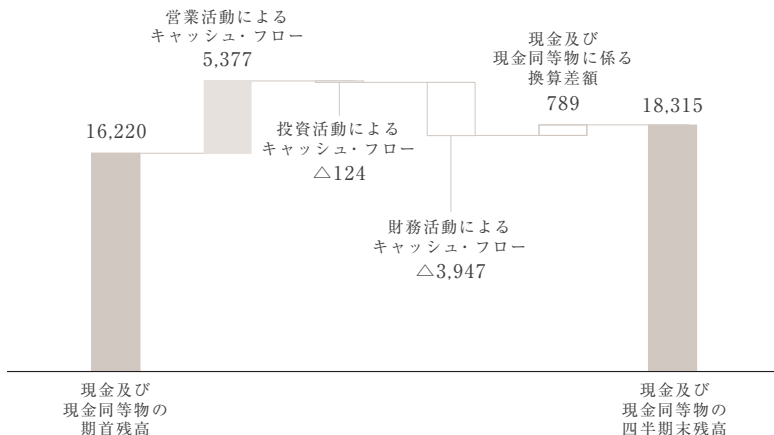
連結財務データ

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間

(2020年10月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)



point
4

営業活動による キャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は53億77百万円となりました。税金等調整前四半期純利益が40億89百万円、売上債権の減少額が23億89百万円となった一方、法人税等の支払額が13億53百万円発生したことなどによります。

point
5

投資活動による キャッシュ・フロー

投資活動により支出した資金は1億24百万円となりました。定期預金の純減少額が4億97百万円、有形固定資産の売却による収入が3億6百万円となった一方、有形固定資産の取得による支出が8億99百万円発生したことなどによります。

point
6

財務活動による キャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は39億47百万円となりました。自己株式の取得による支出が24億94百万円、配当金の支払額が11億86百万円発生したことなどによります。

15

会社情報

(2021年3月31日現在)

会社概要

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	19億25百万円
従業員数	単体：21名(連結1,726名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間 3-2-10 046-271-2111(代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・ 推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	http://www.obara-g.com/

役員

取締役社長	小原 康嗣
取締役	小林 憲史
取締役	山下 光久
社外取締役	大西 倫雄*
社外取締役	牧野 宏司*
常勤監査役	高井 清
社外監査役	須山 正志*
社外監査役	高橋 昌子*

* 証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。

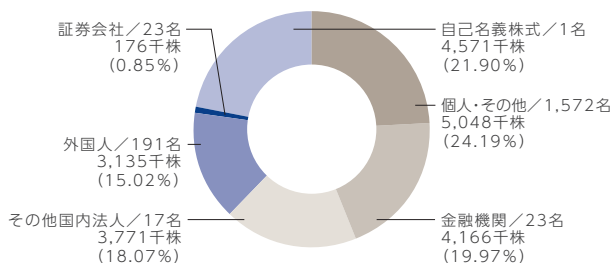
16

株式情報 (2021年3月31日現在)

株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	1,827名

株主分布状況



大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社馬込興産	3,703	22.72
小原 康嗣	2,571	15.77
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	998	6.12
株式会社日本カストディ銀行 (信託口9)	919	5.64
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	570	3.49
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578	459	2.81
JP MORGAN CHASE BANK 385632	379	2.33
株式会社三菱UFJ銀行	369	2.26
小原 範子	304	1.86
吉田 史子	218	1.34

(注) 1. 上記のほか、自己株式4,571千株を保有しております。
2. 持株比率は、自己株式4,571千株を控除して計算しております。
3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数1,084千株を加えて表示しております。

株主メモ

事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会	毎年12月
基準日	定時株主総会の議決権 毎年9月30日 期末配当 毎年9月30日 第2四半期末配当 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。

株主名簿管理人	〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱所 (郵便物送付先 お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL: 0120-782-031(フリーダイヤル)
同取次窓口	三井住友信託銀行株式会社 全国各本支店

公告方法	当公司公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載いたします。 http://www.obara-g.com/ 但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。
------	--

年間IRスケジュール

